



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Mariusz Margalski
ul. Witkiewicza 4, 13-200 Działowo
tel. kom. 501 565 779

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLNEGO Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
DZ. NR 119

Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK

Tytuł rysunku

Sposób klejenia izolacji termicznej

Branża:

A

Skala:

1:10

Data:

05.2011

Autor:

mgr Inż. Andrzej Wiśniewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
Nr ewid. WAM/0143/POOK/08

mgr Inż. arch. Henryka Zawadzka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE:
Nr ewid. 1438/59

Rysunek

13